芯海科技（深圳）股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2023年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式 、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度经营情况报告

2023年度，受全球经济下行以及国内外市场需求不同程度萎缩的长尾影响，2023 年上半年，下游需求整体仍旧表现出较低迷的状态，同时由于产业供应链端库存高带来的供需关系错配，造成了在去库存化过程中部分产品价格承压，部分产品毛利率水平受到较大幅度的影响。2023 年下半年，市场需求开始逐步复苏，同时客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。

2023 年度，公司凭借前瞻性的战略布局和持续的研发创新，紧密跟踪传统领域与新兴市场的动态，成功推出更具竞争力的产品，在细分市场中实现了份额提升。具体情况如下：

（一）抓住市场机遇，开拓新领域和新应用，优化客户结构

公司基于自身在模拟信号链+MCU 双擎驱动的行业领先优势，丰富产品布局和拓展市场应用。报告期内，公司多项产品取得重大突破，产品应用范围从高端消费电子成功扩展到通信与计算机、汽车、工业、大健康等多个细分市场，特别是在手机、笔记本电脑、无人机等领域，突破了长期被海外企业垄断的市场，实现产品规模出货，并与行业内头部客户建立了紧密的战略合作关系，优化了公司

的客户结构。

公司持续在汽车电子领域保持高强度的投入，构建未来可持续竞争与发展的战略布局。不仅完成产品升级和产业链延伸，也推出适应市场需求的新技术、新产品，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势，从而进一步增强公司的核心竞争力。

（二）持续高水平研发投入，保持技术创新与技术领先

集成电路行业是技术密集、资金密集和人才密集型行业，通过持续投入研发，保持技术创新和领先，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户，满足市场及不断发展变化的需求，是公司业务可持续成长的保障和动能来源。

公司一直以来，高度重视研发团队建设及研发过程管理，持续高研发投入。报告期内，公司根据业务战略发展规划，在信号链、工业电子、汽车电子等领域引入多位资深专家，强化关键技术能力。在产品上，坚持产品创新、技术创新，更好贴近市场需求。面向多样化应用场景，提升和满足客户使用体验。2023 年，公司研发投入达到 19,842.14 万元，约占营业收入 45.83%，研发投入较上年度增长 6.60%。

公司在建立技术优势并取得良好市场回报的同时，高度关注技术壁垒的建立。2023 年度，公司新申请发明专利 125 项，获得发明专利批准 39 项；新申请实用新型专利 37 项，获得实用新型发明专利批准 33 项；新申请软件著作权 33 项，获得软件著作权批准 41 项。公司通过专利布局建立深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑知识产权护城河。

（三）先进的质量管理体系及生产流程，确保产品的优越性能

公司按业界最严格的半导体行业标准建立了完备的质量保证体系，秉承“一流设计，一流管理，一流产品，一流服务。创四个一流，使客户满意。”的质量方针，致力于满足乃至超越客户期望。在质量管理上，公司对所有产品实行严密的质量把控，不仅与高可靠性和优异良品率的晶圆代工厂及封测合作伙伴作为供应链的核心环节，同时，每款产品出厂前均需经过全面且高标准的可靠性测试与功能验证程序，在持续丰富产品线的同时，有力保障了产品的高品质属性。随着新产品的研发逐步趋向多功能集成、高端技术应用以及复杂度提升，公司积极采用国际顶尖的工艺制程与封装技术，对芯片产品的可靠性、抗干扰能力、制造良率以及长期稳定性等核心指标设定严苛要求。公司的各项性能参数已达到国内外

同行业的先进水平，这赋予了产品显著的市场竞争力。

值得一提的是，公司已经成功获得 ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质管理体系、ISO26262 功能安全认证、ISO27001 信息安全管理体系以及 ISO22301 业务连续性管理体系等多项质量管理体系的 TUV 莱茵权威认证。这些认证不仅是公司对国际准则的深度接轨，更为其未来的可持续发展与质量管理体系的持续优化奠定了坚实的基础。

（四）加强供应链弹性，提升业务连续性管理能力，提升产品综合竞争力

报告期内，公司在各供应制造环节持续加大投入与布局，深入细致地与供应链伙伴开展战略合作，提升产品综合竞争力。依托公司多元化的产品组合及技术创新，供应链端将持续与国内外策略合作伙伴深化战略合作，共同成长，在保证供应链安全的基础上，持续降本增效。同时，公司在晶圆加工，封测等各环节，进行了多项业务链持续性改善，系统性提升了业务连续性管理能力。此外，随着汽车与工业产品的占比逐渐增加，公司进一步夯实高品质生产制造能力，保持高品质产品稳健交付力。

（五）提升系统性业务及运营管理能力，构建可持续发展内核动能

公司的可持续发展，离不开明确的战略指引、相匹配的组织能力、以及文化内核的沉淀及传承。报告期内，公司进一步提升组织能力，持续深化公司战略管理 DSTE(Develop Strategy To Execution)体系，按照战略制定、战略解码、战略执行监控以及战略执行总结的闭环管理体系，实施战略管理。持续不断深化 IPD(Integrated Product Development)体系，优化了 MM（市场管理）、OR（需求管理）和集成产品开发流程，贯穿市场洞察、产品定义、开发、GTM（Go To Market）过程。报告期内，对产品开发过程活动进行规范管理，强化真正满足客户需求，梳理建立结构合理、层次清晰的完整端到端流程。在开发过程中设置技术评审点和决策评审点，分阶段进行投资决策评审，使产品开发的质量和效率都能得到保障。另外，在 LTC、CRM、EHR 等流程中持续深化数字化转型及流程优化，从“有效”迈向“高效”，进一步提升整体运营和业务流转效率。

在人才和文化方面，公司深化了企业文化建设，明确了公司使命、愿景与价值观，优化了人才吸引、发展、激励与培养机制，以支撑战略落地，提升组织能力，同时为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

（六）加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

截至报告期末，公司员工数达到510人，本科及以上学历员工占比达92.74%，随着人员规模的不断增长，公司加速人才体系化建设，不断健全长效激励机制，为企业技术创新发展提供持续的人才资源，全面提升企业竞争力。

公司历来重视员工的培训和发展工作，配有完善的培训设施及场地，多元化的线上、线下学习平台，为培训实施提供基础保障。公司每年基于未来战略目标实现所需的团队能力，建立系统的培训计划与人才培育项目，不断提升团队核心竞争力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，为提升员工的凝聚力、创造力，保留优秀人才，公司推出了2023年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象总人数为177人，约占公司员工总数的 34.71%。本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。

（七）积极保障投资者权益，提质增效重回报

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合公司自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。规范运作董事会、监事会和股东大会等，确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。2023 年，公司不断提升信息披露水平，按照科创板信披规则要求，及时、准确、完整披露各类经营报告。同时，积极与投资者通过投资者专线、E互动、邮件、业绩说明会等形式交流，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。

二、2023年度董事会日常工作情况

（一）2023年度董事会的会议情况及决议内容

2023 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 12 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2023/1/16	第三届董事会第十六次会议	审议并通过《关于“芯海转债”转股价格调整的议案》《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2023/3/29	第三届董事会第十七次会议	审议并通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会审

会议召开时间	会议届次	审议议案
		计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于作废 2020 年、2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023/4/13	第三届董事会第十八次会议	审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
2023/4/28	第三届董事会第十九次会议	审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2023/6/6	第三届董事会第二十次会议	审议并通过《关于公司对上海证券交易所监管警示决定书相关事项的整改报告的议案》
2023/8/4	第三届董事会第二十一次会议	审议并通过《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》
2023/8/29	第三届董事会第二十二次会议	审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于作废 2021 年第二次限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2023/9/26	第三届董事会第二十三次会议	审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
2023/10/18	第三届董事会第二十四次会议	审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023/10/27	第三届董事会第二十五次会议	审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023/11/7	第三届董事会第二十六次会议	审议并通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》

会议召开时间	会议届次	审议议案
2023/12/11	第三届董事会第二十七次会议	审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2023 年，公司共召开 3 次股东大会：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2023/4/26	2022 年年度股东大会	本次会议共审议了 12 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）
2023/11/7	2023 年第一次临时股东大会	本次会议共审议了 5 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）
2023/12/28	2023 年第二次临时股东大会	本次会议共审议了 2 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-082）

三、公司未来发展战略

芯海科技致力于集成电路技术及应用领域的持续创新，旨在帮助客户创造高价值产品，推动其商业成功。借国家大力发展集成电路产业的东风，公司积极创新，研发出竞争力强的产品与解决方案，力求在市场中占据领先地位，实现企业的快速发展。主要产品技术包括高精度 ADC 和高可靠性 MCU，通用性强，广泛应用于各类场景，市场潜力巨大。

在汽车、工业领域公司主要提供模拟信号链相关的产品和高性能 MCU 产品及无线连接产品，以实现国产替代。在锂电管理领域，公司将提供包括 2-5 节及 12-18 节的各类 BMS 产品来满足高端消费、动力电池、储能和新能源汽车等领域客户的不同需求。在计算机领域，公司可提供嵌入式控制器 EC 芯片、PD 快充协议芯片、USB Hub 芯片、BMS 电量计芯片、Codec 芯片、Haptic Pad、压力触控

芯片等产品，以满足客户的需求。在手机领域，公司将围绕着压力触控及反馈产品、锂电管理等提供各类模拟信号链芯片和快充协议 MCU 芯片。而针对智能家居和家用健康管理设备，芯海将提供集感知、计算、控制、连接于一体的整体解决方案，帮助客户实现传统硬件的快速智能化和联网化。在可穿戴领域，芯海主要提供人机交互和健康测量如 PPG、ECG、BIA 等专用芯片及算法。在机器人领域，公司可以提供 ADC 芯片和压力触控芯片等模拟信号链芯片。

未来，公司的战略方向将主要围绕通信与计算机、锂电管理、工业高精度测量和汽车等方向展开。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日